

Title (en)

Baths and process for chemically polishing copper or copper alloy surfaces.

Title (de)

Bäden und Verfahren zum chemischen Polieren von Oberflächen aus Kupfer oder Kupferlegierungen.

Title (fr)

Bains et procédé pour le polissage chimique de surfaces en cuivre ou en alliage de cuivre.

Publication

EP 0309031 A1 19890329 (FR)

Application

EP 88201981 A 19880913

Priority

FR 8713407 A 19870925

Abstract (en)

[origin: US4981553A] Baths for the chemical polishing of copper or copper alloy surfaces, comprising, in aqueous solution, hydrogen peroxide, chloride ions, phosphoric acid and phosphate and hydrogenphosphate ions, in quantities adjusted so as to impart a pH of between 1.25 and 3 to the bath.

Abstract (fr)

Bains pour le polissage chimique de surfaces en cuivre ou alliage de cuivre, comprenant, en solution aqueuse, du peroxyde d'hydrogène, des ions chlorure, de l'acide phosphorique et des ions phosphate et hydrogénophosphate en quantités réglées pour conférer au bain un pH compris entre 1,25 et 3.

IPC 1-7

C23F 3/06

IPC 8 full level

C23F 3/00 (2006.01); **C23F 3/06** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

C23F 3/00 (2013.01 - KR); **C23F 3/06** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] GB 1449525 A 19760915 - TOKAI ELECTRO CHEMICAL CO
- [A] FR 2578261 A1 19860905 - ENTHONE
- [A] EP 0115450 A1 19840808 - ATOCHEM [FR]
- [XD] SOVIET INVENTIONS ILLUSTRATED, vol. 6, no. 8639, 9 octobre 1986, résumé no. 86-257473/39, Derwent Publications Ltd, Londres, GB; & SU-A-12 11 338 (ORG. PHYS. CHEM. INST.) 15-02-1986

Cited by

BE1003944A3; EP0425012A1; US5098517A; BE1003761A3; WO9206122A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0309031 A1 19890329; BR 8804929 A 19890502; DK 529488 A 19890326; DK 529488 D0 19880923; FI 884332 A0 19880921; FI 884332 A 19890326; FR 2621052 A1 19890331; JP H01159385 A 19890622; KR 890005300 A 19890513; NO 884228 D0 19880923; NO 884228 L 19890328; US 4981553 A 19910101

DOCDB simple family (application)

EP 88201981 A 19880913; BR 8804929 A 19880923; DK 529488 A 19880923; FI 884332 A 19880921; FR 8713407 A 19870925; JP 24063688 A 19880926; KR 880012138 A 19880920; NO 884228 A 19880923; US 24534088 A 19880916